

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2023-015

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于分公司重大项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（以下简称“亚翔新加坡分公司”）于近日收到United Microelectronics Corporation (Singapore Branch)（联华电子股份有限公司新加坡分公司）发来的订单（编号：2484575 -12I1ADF、2484586 -12I1ADF、2484581 -12I1ADF、2484578 -12I1ADF、2484583 -12I1ADF），确认亚翔新加坡分公司成为联华电子「新加坡12吋晶圆厂第三厂/第四厂扩建工程」之无尘室(20K)、制程管路(含共同管架)(20K)、空调、消防/给排水/LPG、电力/弱电(含电梯)劳务安装工程的承包单位。现将相关情况公告如下：

一、业主信息

联华电子股份有限公司（以下简称“联电”）为全球半导体晶圆专工业界的领导者，提供高质量的晶圆制造服务，专注于逻辑及特殊技术，为跨越电子行业的各项主要应用产品生产芯片。联电完整的制程技术及制造解决方案包括逻辑/混合信号、嵌入式高压解决方案、嵌入式非挥发性内存、RFSOI 及 BCD。

二、中标项目概况

- 1、项目名称：联华电子「新加坡12吋晶圆厂第三厂/第四厂扩建工程」之无尘室(20K)、制程管路(含共同管架)(20K)、空调、消防/给排水/LPG、电力/弱电(含电梯)劳务安装工程
- 2、项目地址：3 PASIR RIS DRIVE 12, SINGAPORE 519528
- 3、招标单位：United Microelectronics Corporation (Singapore Branch)（联华电子股份有限公司新加坡分公司）
- 4、建设单位：United Microelectronics Corporation (Singapore Branch)（联华电子股份有限公司新加坡分公司）
- 5、中标金额：SGD 364,331,968（大写：新加坡元叁亿陆仟肆佰叁拾叁万壹仟玖佰陆拾捌元整）（未税）
- 6、工程期限：预计工期到2024年12月
- 7、工程概况：新加坡Fab 12i P3厂位于白沙芯片园（Pasir Ris Wafer Park），土地面积约11.17万平方米，预计2025年量产，以22纳米及28纳米制程生产。主要针对5G、物联网和车用电子的需求。本中标项目为P3厂的无尘室(20K)、制程管路(含共同管架)(20K)、空调、消防/给排水/LPG、电力/弱电(含电梯)劳务安装工程。

三、本项目执行对公司的影响

本项目的顺利实施将有助于提高公司在海外工程的业务承接能力，为公司后续国际工程项目的开拓和合作提供更多国际的经验，并将对公司的经营业绩和工程管理人才产生积极影响。

四、风险提示

公司需与发包单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2023年3月22日